

RESIN COMPOSITION AND MOLDED ARTICLE THEREOF

Patent Number: JP62132952
Publication date: 1987-06-16
Inventor(s): INASAWA SHINTARO; others: 01
Applicant(s): SHOWA DENKO KK
Requested Patent: JP62132952
Application Number: JP19850273425 19851206
Priority Number(s):
IPC Classification: C08L29/04; C08L77/00
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:A melt moldable composition, obtained by melt blending polyvinyl alcohol with a polyamide based resin and capable of being molded articles, e.g. films, pipes, etc., having improved antistatic and soiling preventing proper ties.

CONSTITUTION:A composition obtained by melt blending (A) 20-80pts.wt. polyvinyl alcohol with (B) 80-20pts.wt. polyamide based resin. the resultant composition is hot-molded to give a molded article having $10^{12} \sim 10^6$ OMEGA surface resistivity value. Polyvinyl alcohol, containing ≥ 97 mol% vinyl alcohol units as a monomer and having 500-4,000 polymerization degree is preferred for the component (A). A copolyamide, prepared by blending nylon 6 with nylon 6, 6 at 97:3-80:20 weight ratio and having ≤ 230 deg.C melting point is preferred for the component (B).

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-132952

⑪ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)6月16日

C 08 L 29/04

L G U

8620-4J

77/00

L Q S

8416-4J

//(C 08 L 29/04

77:00)

(C 08 L 77/00

29:04)

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

⑭ 発明の名称 樹脂組成物およびその成形品

⑯ 特 願 昭60-273425

⑰ 出 願 昭60(1985)12月6日

⑱ 発 明 者 稲 沢 伸 太 郎 大分市大字中の洲2 昭和電工株式会社内

⑲ 発 明 者 鈴 木 稜 大分市大字中の洲2 昭和電工株式会社内

⑳ 出 願 人 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号

㉑ 代 理 人 弁理士 青 木 朗 外4名

明 細 書

1. 発明の名称

樹脂組成物およびその成形品

2. 特許請求の範囲

1. ポリビニールアルコール20重量部超80重量部以下及びポリアミド系樹脂80重量部未満20重量部以上を熔融混合してなる帯電防止性及びほこり付着防止性に優れた樹脂組成物。

2. ポリビニールアルコール20重量部超80重量部以下及びポリアミド系樹脂80重量部未満20重量部以上を熔融混合してなる樹脂組成物を熱成形してなる表面固有抵抗値が $10^{12} \sim 10^6 \Omega$ の帯電防止性及びほこり付着防止性に優れた成形品。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は帯電防止性及びほこり付着防止性に優れたかつフィルム、パイプ、シート、フィラメント又は押出成形品、射出成形品などに熔融成形が可能な樹脂組成物及びその成形品に関する。

従来技術

プラスチックの帯電防止及びほこり付着防止については、多年に渉り努力が払われてきたが、未だ満足すべきものが見出されていないのが現状である。特に最近ICなどの電子精密部品の発達に伴ない、その包装時や輸送時などの静電気防止には特に注意が払われ、これらの包装に用いるための包装材料が種々開発されているが、未だ充分な効果が得られていない。即ち、現在迄の帯電防止及びほこり付着防止の方法としては、帯電防止剤の混入、練り込み、塗布などによる方法が知られているが、これらの方法は、帯電防止剤が大気中に徐々に飛散したり、輸送時の擦れ、衝撃、振動などによって帯電防止剤が成形品表面から剝落したりするために、その効果を長く持続せしめることができないのが現状である。即ち、従来は、例えば、電子精密製品又はその部品の梱包に用いられる、いわゆる型物に対して、静電気防止のために導電性カーボンブラックが添加されているが、輸送時の振動、衝撃などにより導電性カーボン